

【原因、判断要点、发生工序】DFR 显影剥离的残渣，或者剥离后再次粘附 DFR 屑，未经处理残留在 SR 基底而引起的（DFR 现像退膜工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Un-removed dry film debris in developing or reattached dry film debris once removed is left under solder resist as is. (Dry film development process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×

2-2-1-13 SR はんだ付着／SR 附着焊料／Attached solder on solder resist area

【特徴】SR 部にはんだが付着している状態の欠陥

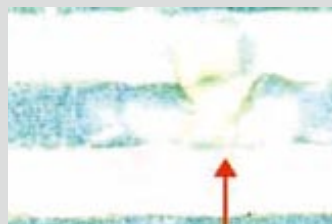
【特征】SR 附着焊料の缺陷。

【Characteristics】Solder is attached to solder resist area.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR が傷や衝撃などで剥がれた部分にはんだが付着してできたもの（HAL 工程）

【原因、判断要点、发生工序】在 SR 损伤和受冲击等的剥落部位附着焊料所引起的（HAL 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】Solder is attached to the area where solder resist is peeled off due to a defective surface or by an impact, causing the defect. (HAL process)



【コメント】
顕微鏡倍率×175
【注釋】
显微镜倍率 ×175
【Comments】
Magnification: ×175



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×

2-2-1-14 SR はじき／SR 迸开变薄／Cratered solder resist

【特徴】SR がクレータ状に薄くなっている状態の欠陥。単独の発生もあるが複数発生している場合が多い

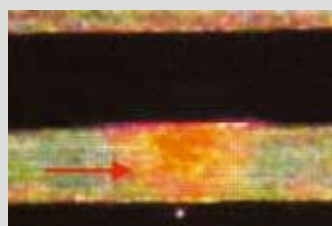
【特征】SR 像弹坑那样变薄的缺陷。虽有个别现象发生，但大多数是同时发生。

【Characteristics】Solder resist becomes locally thin like a crater. The defect is sometimes isolated single defect but often multiple defects exist.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR の下地に付着した異物や SR 中に紛れ込んだ異物を核として、SR がクレータ状に弾いて出来たもの（SR 塗布工程）



【コメント】
顕微鏡倍率×55
【注釋】
显微镜倍率 ×55
【Comments】
Magnification: ×55



【コメント】
SR はじき部拡大
顕微鏡倍率×150
【注釋】
SR 迸开部位的放大
显微镜倍率 ×150
【Comments】
Enlarged photo of
cratered solder resist
area
Magnification: ×150